

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研		<input type="checkbox"/> 分析师会议	
	<input type="checkbox"/> 媒体采访		<input type="checkbox"/> 业绩说明会	
	<input type="checkbox"/> 新闻发布会		<input type="checkbox"/> 路演活动	
	<input type="checkbox"/> 现场参观		<input type="checkbox"/> 电话会议	
	<input type="checkbox"/> 其他			
参与单位名称	单位	姓名	单位	姓名
	建信基金	郭帅彤	国金证券	赵晋
	敦和资产	李乾	富达基金	陈月桥
会议时间	2023年7月			
会议地点	公司会议室、网络会议			
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书兼财务总监 辜诗涛先生			
投资者关系活动主要内容介绍	<ul style="list-style-type: none">● 董事会秘书辜诗涛先生作公司简要情况介绍● 提问环节 <p>(一) 公司测试的定价方式？</p> <p>公司测试服务定价的影响因素和影响机制：</p> <p>(1) 测试设备：常温、低温、高温探针台/分选机及其他配置；</p> <p>(2) 测试工艺流程：不同类型的芯片会有测试工序的差别，例如是否需要做多道测试、电性抽测、老化测试、光学外观检测及特殊包装等工序；</p> <p>(3) 环境因素：生产车间的洁净度和温湿度要求差异，生产洁净车间有万级、千级、百级等差别，温湿度要求精准控制。例如</p>			

CIS 产品需要百级以上洁净车间，算力芯片要求温度控制在正负 1℃ 以内；

(4) 技术难度:不同的客户产品使用不同的测试方案。测试方案开发难度与公司投入研发的技术人员资历、数量、开发周期和开发难度、开发过程中所投入的资金有关。测试技术越领先或具有独特性，则价格更高。

除上述因素外，还受质量要求、服务要求、测试的订单量、产能需求等影响。

(二) 未来产能布局的计划？东莞和上海未来产能投入情况？

公司根据市场情况，主动为客户的未来产能需要做出的合理预判，提前布局相应的产能，持续扩充测试产能，产能规模不断上升，应对未来市场需求；公司将积极在 5G 通讯、传感器、存储器、高算力、AIoT、汽车电子等领域的芯片测试产能投入，并将优先选择全球知名的测试平台。

(三) 在中美贸易的大环境下，请问测试厂商的设备是否受限？

美国主要是针对晶圆制造端先进工艺领域的限制。截至目前，美国对测试设备没有限制。

(四) 公司与其他第三方专业测试服务厂商的比较优势？

目前中国台湾存在多家规模较大的专业测试上市公司，如京元电子、矽格、欣铨等，利扬芯片与台湾测试公司相比，具有区位和文化优势，目前国内为全球最大的电子产品市场之一，国内的芯片设计公司也迎来高速增长。由于芯片设计公司需与集成电路测试公司进行密切合作，在测试的过程中需要深入沟通具体技术问题，考虑到芯片设计领域的技术保密性，国内越来越多的大型芯片设计公司未来会逐渐将测试需求转向国内，优先选择国内的测试公司。公司自成立以来，一直专注于集成电路测试领域，并在该领域积累了多项自主的核心技术，为知名芯片设计公司提供

中高端芯片独立第三方测试服务，工艺涵盖 3nm、5nm、8nm、16nm 等先进制程。公司已拥有数字、模拟、混合信号、存储、射频等多种工艺的 SoC 集成电路测试解决方案，仍将不断加大研发投入力度，进一步夯实领先优势的测试技术，积极开发满足不同应用领域的芯片测试解决方案，重点布局 5G 通讯、传感器（MEMS）、存储（Nor/Nand Flash、DDR 等）、高算力（CPU、GPU 等）、人工智能（AI）、汽车电子、智能物联网（AIoT）等芯片的测试解决方案，并以此方向进一步拓展市场。

（五）公司在汽车电子领域是否有对应的测试方案和客户量情况如何？可介绍这类客户的类型和主营业务？

公司早在 2018 年获得与汽车电子相关的认证，目前涉及到的汽车电子芯片有 MCU、多媒体主控芯片、传感器等领域；对此公司都有一定的测试技术储备，满足设计公司的测试需求。目前汽车电子对我们营业收入贡献较小。汽车电子芯片与传统的测试不一样，除常温测试外，还要做高温、低温测试，如有存储单元的，还要进行老化测试。

公司积极组建高可靠性芯片三温测试专线，可适用于各种高可靠性芯片（包括 GPU/CPU/AI/FPGA/车用芯片等）的量产化测试需求，包括 ATE 测试、SLT 测试、老炼测试等，从而满足其终端应用对于芯片性能的严苛要求，结合公司自研的 MES 系统，满足芯片高可靠性的质量需求。

随着国内新能源汽车的普及，车用芯片迎来国产替代的历史机遇，公司将积极加大高可靠性芯片的三温（常、低、高）测试专线投入，并且在智能座舱、辅助、自动驾驶等领域的芯片测试技术研发。特别在自动驾驶涉及到单光轴多光谱图像传感器芯片，采用叠堆式 3D 封装测试，公司将继续加大此方面的测试研发投入和产能布局。

（六）公司有采购国产测试设备吗？

	<p>公司设备选型/采购主要关注设备的可靠性、稳定性、一致性。目前公司有采购华峰测控、联动科技、胜达克、珠海芯业等国内厂商的测试设备。但总体来说，国外的测试设备仍有较大优势，公司现有的测试设备仍以进口为主。</p>
--	---